

# 第119回(2024年度春季)全国講演大会プログラム

第1日 7月3日(水) 大阪科学技術センター 大ホール

9:30~9:40	開会の辞： 大会実行委員長 笹岡 秀紀 開会挨拶： 日本溶射学会会長 小川 和洋		
9:40~11:00	セッション1： 溶射材料・コールドスプレー		
講演番号	講演題目	講演者	○印発表者
101	P置換Ni自溶合金における低温フュージングの検討	山陽特殊製鋼(株) 〃	○ 廣野 友紀 澤田 俊之
102	NiCu系バインダーによるカーバイドHVOF皮膜の機械的特性および耐食性	エリコンジャパン(株) 〃 〃	○ 山根 俊幸 藤森 和也 和田 哲義
103	低圧コールドスプレー法で作製したアルミニウム合金積層体に及ぼす混合粒子の効果	東北大学大学院(院生) 東北大学 〃 〃	○ 舟木 大河 齋藤 宏輝 市川 裕士 小川 和洋
104	低圧コールドスプレー法による窒化アルミニウム基板上のアルミニウム皮膜の密着力に及ぼす基板温度と後熱処理の影響	信州大学 信州大学大学院(現 榊前田製作所) 信州大学大学院 長野県工業技術センター	○ 榊 和彦 芦田 健 津浦 真実 傳田 直史
11:00~11:30	溶射交流会 プレゼンテーション		司会 原田 一志
11:30~13:00	昼 休 み 社員総会 (11:40~12:50)		
13:00~15:15	オーガナイズドセッション 「溶射」特集記事連動企画 『ナノ粒子/微粉末を利用した溶射技術』		司会 市川 裕士
OS1	SDGs時代における低コストと高環境性を両立したナノ材料プロセッシング	東北大学	山中 俊輝
OS2	プラズマスプレー法を利用したシリコンナノ材料開発の進展	大阪大学	神原 淳
OS3	高周波誘導熱プラズマ装置による粒子生成と成膜プロセス	日本電子(株)	横山 卓司
OS4	セラミック微粉末によるプラズマ溶射の試み	(国研)産業技術総合研究所	鈴木 雅人
	パネルディスカッション		
15:15~15:40	休 憩 ・ 展 示 交 流 会		
15:40~16:40	特別講演1 『これからの半導体パッケージング技術開発(仮)』 大阪大学 産業科学研究所 フレキシブル3D実装協働研究所		司会 小川 和洋 菅沼 克昭
16:40~17:10	表彰式		
18:00~	懇親会： フェスティバル&ビアホール (フェスティバルプラザ2F)		

溶射交流会

(小ホール)

第2日 7月4日(木) 大阪科学技術センター 大ホール

9:40～11:20 セッション2 : 皮膜特性			
講演番号	講演題目	講演者	○印発表者
溶 射 交 流 会  ( 小 ホ ー ル )	201	セラミック溶射自立膜における共振法を用いた動弾性係数測定とポアソン比の推定	テクノクオーツ(株) 〇 加藤 征秀 梅津 康浩 松浦 陽
	202	デジタル画像相関法による高温場TBC曲げ試験の非接触ひずみ計測	三菱重工業(株) 〇 武野 和馬 岡嶋 芳史 鳥越 泰治
	203	プラズマ溶射HAp複合皮膜の残留応力に及ぼす熱処理およびSBF浸漬の影響	新潟大学 新潟大学大学院 新潟大学 〇 大木 基史 杉田 翔大 齋藤 浩
	204	HVOF溶射したWC-12Co皮膜の硬さの異方性と空隙形態	トーカロ(株) 〇 小林 圭史 進藤 亮太 田中 倫規
	205	プラズマ溶射ZrO <sub>2</sub> -Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> コーティングの熱時効による相変態挙動	東京都立大学 元 東京都立大学 日本電子(株) 〇 高橋 智 森 義忠 近藤 行人
11:20～13:00 昼 休 み			
13:00～14:00 特別講演2 『めっき技術の基礎と産業利用の現状』			司会 高橋 智 元 大阪産業技術研究所 藤原 裕
14:00～14:15 休 憩			
14:15～15:15 セッション3 : 溶射プロセス・後処理			
)	206	微粉末を用いて作成したアルミナ溶射被膜の絶縁耐力に対する基材特性と成膜時基材温度の影響	大島商船高等専門学校 〇 笹岡 秀紀
	207	粉末式レーザー溶射/粉末式レーザーDEDの積層モードの違いと加工選択性	(国研)産業技術総合研究所 〇 廣瀬 伸吾 江塚 幸敏
	208	重回帰分析を用いたステンレス鋼クラッド層の合金組成と窒化層の特性の検討	(地独)大阪産業技術研究所 〇 足立振一郎 山口 拓人 田中 慶吾
15:15～15:30 ベストプレゼンテーション賞表彰:若手の会会長 渡邊 悠太 閉会の辞: 大会実行委員長 小川 和洋			